

# 双组分导热填缝剂



## 产品特性

- 可室温固化或加热固化
- 界面润湿效果优异
- 优异的耐老化性能
- 良好的存储稳定性



## 产品简介

### SDG系列

测试项目	SDG020	SDG020LW	SDG040	SDG060	SDG080	SDG100	SDG120
<b>固化前产品特性</b>							
A/B外观	蓝色/黄色	白色/红色	浅灰/蓝色	浅红/浅灰	红色/灰色	红色/灰色	红色/灰色
混合粘度 (Pa·s)	400	130	420	420	540	400	430
操作时间 (min)	60	90	60	120	120	60	120
<b>固化后产品特性</b>							
硬度 (Shore OO)	50	55	65	60	65	65	67
密度(g/cm <sup>3</sup> )	2.6	2.0	3.1	3.3	3.3	3.1	3.2
体积电阻率 (ohm-cm)	1*10 <sup>12</sup>	1*10 <sup>12</sup>	1*10 <sup>13</sup>	1*10 <sup>12</sup>	1*10 <sup>12</sup>	1*10 <sup>12</sup>	1*10 <sup>12</sup>
介电强度 (kV/mm)	12	12	13	11	7	9	6
导热系数 (W/(m·K))	2.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0
阻燃	V-0相当						

\*上述数据仅为实验室测试典型值，不应被视为产品性能使用  
\*上述产品为市场需求标准产品，另有部分定制化产品

# 单组分导热凝胶



## 产品特性

- 单组份预固化
- 界面润湿效果优异
- 有效缓冲元器件老化膨胀
- 自动化施工
- 可返修性



## 产品简介

### STG系列

测试项目	STG035	STG040	STG060	STG080	STG100	STG120
<b>产品特性</b>						
外观	蓝色	蓝色	红色	蓝色	灰白色	灰白色
粘度(Pa·s)	1500	1500	1200	1200	1400	1500
密度(g/cm <sup>3</sup> )	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3
BLT(μm)	80	150	150	200	200	200
体积电阻率 (ohm-cm)	1*10 <sup>12</sup>					
介电强度 (kV/mm)	6	6	5	5	5	5
热阻 (°C·cm <sup>2</sup> /W)	0.30	0.34	0.23	0.35	0.29	0.26
导热系数 (W/(m·K))	3.5	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0
挤出速率 (g/min)	65	25	16	18	16	16

\*上述数据仅为实验室测试典型值，不应被视为产品性能使用  
\*上述产品为市场需求标准产品，另有部分定制化产品

# 导热硅脂



## 产品特性

- 粘度低、触变好，适合点胶、丝网、钢板印刷
- 低热阻、低挥发
- 无溶剂型配方
- 优异的绝缘性、耐老化性能
- 室温存储，稳定性好



## 产品简介

### SG系列

测试项目	SG010	SG020	SG030	SG031	SG060
<b>产品特性</b>					
外观	白色	白色	白色	白色	灰色
粘度(Pa·s)	300	300	140	100	400
密度(g/cm <sup>3</sup> )	2.4	4.0	3.2	3.4	3.2
BLT(μm)	35	10	70	10	60
体积电阻率 (ohm-cm)	1*10 <sup>12</sup>				
介电强度 (kV/mm)	6	6	5	5	5
热阻 (°C·cm <sup>2</sup> /W)	0.248	0.100	0.220	0.060	0.140
导热系数 (W/(m·K))	1	2	3	3	6
适用温度范围 (°C)	-40~180	-40~180	-40~180	-40~180	-40~180

\*上述数据仅为实验室测试典型值，不应被视为产品性能使用  
\*上述产品为市场需求标准产品，另有部分定制化产品

# 灌封胶

## 产品特性

- 低粘度，更好的工艺性
- 良好的防沉降性能
- 可加热或室温固化
- 低收缩率、附着力强
- 绝缘防潮、耐酸碱



## 产品简介

### SP、ETP等系列

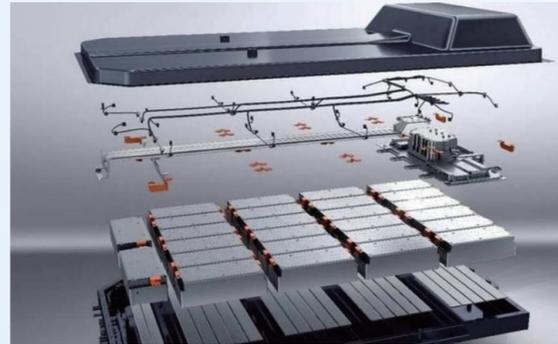
测试项目	粘度 (cps)	密度 (g/cm³)	操作时间 (min)	硬度 (Shore A)	体积混合比	导热系数 (W/(m·K))	适用温度范围℃
<b>有机硅体系</b>							
SP009	1000-4000	1.6	30	35	1:1	1.0	-40~180
SP020	3000-6000	2.6	30	25	1:1	2.0	-40~180
SP030	7000-10000	3.0	30	25	1:1	3.0	-40~180
SP040	11000-15000	3.3	30	65 (00)	1:1	4.0	-40~180
SP001LD	1600-2600	0.6	14	35	1:1	非导热产品	-40~85
<b>环氧体系</b>				<b>(Shore D)</b>	<b>质量混合比</b>		
ETP106	1000-3000	1.53	120	82	100:13	0.6	-40~125
ETP 310	4000-7000	1.60	180	87	单组份	1.0	-40~150
ETP510	6000-10000	2.11	240	90	1:1	1.0	-40~180
ETP520	9000-15000	2.85	240	92	1:1	2.0	-40~200
EP505	3000-8000	1.80	80℃ 1h + 120℃ 2h + 150℃ 2h	90	单组份	非导热产品	-40~230
EP560	6000-12000	1.08	120	70	2:1	非导热产品	-40~125
<b>杂化体系</b>				<b>(Shore A)</b>			
HP130	5000-10000	0.99	UV+湿气双 固化	25	单组份	非导热产品	-40~150

\*上述数据仅为实验室测试典型值，不应被视为产品性能使用  
\*上述产品为市场需求标准产品，另有部分定制化产品

# 结构胶

## 产品特性

- 高粘接强度、高断裂伸长率
- 低压合力
- 较低粘度，易于施胶，降低设备磨损
- 良好的耐老化性能



## 产品简介

### UB、EB等系列

测试项目	粘度 (Pa·s)	密度 (g/cm³)	操作时间 (min)	硬度 (Shore D)	导热系数 (W/(m·K))	剪切强度 (MPa)
<b>聚氨酯体系</b>						
UTB080	95	1.65	15	65	0.8	8
UTB120	150	1.77	15	60	1.2	10
UTB200	470	2.17	30	65	2.0	11
UTB300	220	2.65	25	60	3.0	3
UB232	-	1.41	20	70	非导热产品	12
UB249	130	1.55	15	65	非导热产品	15
<b>环氧体系</b>			<b>固化时间</b>			
EB316	150	1.48	40min @ 120℃	82	非导热产品	19
EB330	30-50	1.20	15min @ 155℃	85	非导热产品	25

\*上述数据仅为实验室测试典型值，不应被视为产品性能使用  
\*上述产品为市场需求标准产品，另有部分定制化产品

# AA胶

## 产品特性

- UV快速固化定位
- 单组分，可自动点胶
- 对多种基材具有较好的粘接性
- 优异的耐老化性能
- 低收缩、低应力



## 产品简介

### HA系列

测试项目	HA220	HA261	HA263	HA267	测试标准
产品体系	有机硅	环氧	环氧	环氧	-
颜色	偏黄/半透明	偏黄/半透明	偏黄/半透明	偏黄/半透明	目视
固化模式	UV+热	UV+热	UV+热	UV+热	-
UV固化时间(s)	3-6 @365nm 1000- 2000mW/cm³	3-6 @365nm 500- 2000mW/cm³	3-6 @365nm 1000- 2000mW/cm³	3-6 @365nm 200- 2000mW/cm³	-
热固化条件	60min @ 110℃	60min @ 110℃	60min @ 100℃	60min @ 85℃	-
粘度 (Pa·s)	100	10	18	20	GB/T 2794
触变系数	4.5	5	5	4	GB/T 2794
玻璃化转变温度 (℃)	-40	30	125	160	ASTM E831
热膨胀系数 (ppm/℃)	240	70	60	30	ASTM E831
本体强度 (MPa)	3	6	-	-	GB/T 528
固化深度 (mm)	2	2	2	2	-
DIE Shear@Glass (MPa)	2.2 (Lap shear)	25	25	15 (PCB)	-
体积收缩率 (%)	-	2.0	2.0	1.4	GB/T 24148.9

\*上述数据仅为实验室测试典型值，不应被视为产品性能使用  
\*上述产品为市场需求标准产品，另有部分定制化产品